

平成30年3月12日

各位

会社名 株式会社ブイ・テクノロジー  
代表者 代表取締役社長 杉本 重人  
(コード番号：7717 東証一部)  
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
(TEL：045-338-1980)

## 合弁会社設立に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク 9F、以下、当社）は、海寧瑞美科技有限公司（中華人民共和国浙江省海寧市経済開発区隆興路 118 号、以下、海寧瑞美科技）との間で合弁会社「浙江芯暉設備技術有限公司（以下、浙江芯暉設備技術）」の設立を決議し、海寧瑞美科技と正式に合意に至りましたことを下記の通り、ご報告いたします。

## 記

## 1. 合弁会社設立の目的

中国においては、自国の半導体産業の成長と半導体の自給率を高める為の様々な取り組みが継続されており、半導体工場の新設および半導体ウェハ工場新設の動きが活発化しています。

当社および海寧瑞美科技は、世界で最も市場成長が期待できる中国市場を最優先地域と考え、当地の様々なニーズに応える、顧客密着型の製造装置メーカーとして浙江芯暉設備技術を設立しました。同社は、事業展開の第一段としてウェハ研磨用に開発が完了した技術を用いた半導体用ウェハの研磨装置事業に取り組みます。また、中長期的には研磨装置事業以外の製造装置への展開も視野に事業を発展させる見通しです。

## 2. 設立する合弁会社の概要

(1) 商号	浙江芯暉設備技術有限公司 (Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.)
(2) 所在地	浙江省海寧市海寧経済開発区隆興路 118 号内メイン事務棟 370 室
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事業内容	半導体製造装置、半導体ウェハ研磨関連装置、及び部品の研究開発・生産・販売と関連する業務、技術開発・技術移転・技術コンサルタントと技術サービス、製品の輸出入・技術の輸出入・輸出入の代理業務、およびそれらの業務に付帯する一切の業務。
(5) 資本金	12 百万 USD（合弁会社設立後 1 年間以内に出資完了予定）
(6) 出資比率	当社：40%、海寧瑞美科技：60%

## 3. 合弁相手先の概要

(1) 商号	海寧瑞美科技有限公司
(2) 所在地	浙江省海寧市海寧経済開発区隆興路 118 号内メイン事務棟 212 室
(3) 代表者の役職・氏名	杜泓標
(4) 事業内容	画像処理設備、半導体装置及び消耗品の研究開発
(5) 資本金	67 百万 CNY
(6) 設立年月日	2017 年 12 月 8 日
(7) 出資比率	浙江省海寧市衆力産業投資有限公司：30% 浙江省海寧市宏毅投資有限公司：70%

## 4. 日程

取締役会決議日	2018 年 3 月 9 日
契約締結日	2018 年 3 月 9 日
合弁会社設立日	2018 年 4 月（予定）

## 5. 今後の見通し

2018 年 3 月期業績見通しへの影響は軽微となる見込みです。その他、開示すべき重要な事項がございません場合には、別途速やかに開示いたします。

以上

参考資料：建物イメージ



赤枠内が合弁会社。建物面積 55,800 m<sup>2</sup>のうち 15,000 m<sup>2</sup>を半導体関連製造装置の開発、製造に供用予定。2019 年 4 月完成予定。